



ALADI/AAP.CE/18.90
18 de octubre de 2011

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY

Nonagésimo Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE 18 y la Resolución GMC N° 43/03,

CONVIENEN:

Artículo 1º - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 la Directiva N° 07/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen", que consta como Anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2º - El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

Artículo 3º - Una vez en vigor, el presente Protocolo modificará el Anexo al Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional al ACE N° 18 -Anexo I de la Directiva CCM N° 10/07-, y el Anexo al Septuagésimo Séptimo Protocolo Adicional al ACE N° 18 - Apéndice I de la Decisión CMC N° 01/09; y derogará el Octogésimo Primer y el Octogésimo Segundo Protocolos Adicionales al Acuerdo de Complementación Económica N° 18.0

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los doce días del mes de octubre del año dos mil once, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. (Fdo.): Por el Gobierno de la República Argentina: Daniel Raimondi; Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Otávio Brandelli; Por el Gobierno de la República del Paraguay: Alejandro Hamed Franco; Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena.

ANEXO

**SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 11/08/11**

**Agustín Colombo Sierra
Director**

MERCOSUR/CCM/DIR Nº 07/11

ADECUACION DE REQUISITOS ESPECIFICOS DE ORIGEN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 08/03 y 01/09 del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones Nº 29/10, 30/10 y 47/10 del Grupo Mercado Común y las Directivas Nº 10/07, 21/09 y 22/09 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.

CONSIDERANDO:

Que el Régimen de Origen MERCOSUR faculta a la Comisión de Comercio del MERCOSUR a modificar dicho Régimen por medio de Directivas.

Que es necesario adecuar los requisitos específicos de origen del Régimen de Origen del MERCOSUR a las modificaciones en la Nomenclatura Común del MERCOSUR.

Que es necesario actualizar los requisitos específicos de origen del Régimen de Origen del MERCOSUR para los Bienes de Informática y Telecomunicaciones.

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Decisión CMC Nº 08/03, “mientras una norma que derogue una o más normas anteriores no entre en vigencia de acuerdo con el Artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto, continuarán vigentes las normas anteriores que pretendan derogarse, siempre que hubieren sido incorporadas por los cuatro Estados Partes”

Que en función de ello, resulta conveniente adoptar medidas transitorias con vistas a agilizar la entrada en vigencia de los requisitos de origen para facilitar la operativa comercial entre los Estados Partes.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1 – Modifícase el Apéndice I de la Decisión CMC Nº 01/09, conforme consta en los Anexos I y II que forman parte de la presente Directiva.

Art. 2 - Hasta tanto la Decisión CMC Nº 01/09 entre en vigencia, las modificaciones establecidas en el Artículo 1º se aplicarán al Anexo I de la Directiva CCM Nº 10/07, donde corresponda.

Art. 3 - Deróganse las Directivas CCM Nº 21/09 y Nº 22/09.

Art. 4 – Solicitase a los Estados Partes que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC N° 43/03.

Art. 5 – Esta Directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 31/X/2011.

CXX CCM – Montevideo, 19/V/11

ANEXO I

a) Incorporar al listado:

| NCM2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|--|
| 2102.10.10 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 2102.10.90 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.11.20 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.11.30 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.11.40 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.12.30 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.12.40 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.12.50 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.13.30 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.13.40 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.13.50 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.14.20 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.14.30 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.14.40 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.91.10 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.91.20 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.91.30 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.91.90 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.92.20 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.92.30 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.92.40 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.93.20 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.93.30 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.93.40 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.94.10 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.94.20 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.94.30 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.94.90 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 7304.51.11 | Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes. |
| 7304.51.19 | Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes. |
| 9006.10.10 | 60% de valor agregado regional. |
| 9006.10.90 | 60% de valor agregado regional. |

b) Eliminar del listado:

| NCM2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|---|
| 2102.10.00 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.91.00 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 5603.94.00 | Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional |
| 7304.51.10 | Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.. |
| 9006.10.00 | 60% de valor agregado regional. |

ANEXO II

a) Sustituir del listado:

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|---|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8443.32.21 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8443.32.22 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8443.32.23 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera), y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | |
| 8443.32.29 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8443.32.35 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8443.32.39 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8443.32.51 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8443.32.59 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8470.50.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8470.50.19 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.30.12 | MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.- | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.30.19 | MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.- | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8471.30.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.41.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.50.10 | UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUEÑA CAPACIDAD. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementan las funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video, acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener un montaje y soldadura de todos los componentes. B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" e "B" anteriores. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. En las unidades digitales de procesamiento del tipo "discless", destinadas a interconexión en redes locales, el montaje de la placa que implementa la interfase de red local podrá sustituir el montaje de las placas que implementan las interfases en serie, paralela y de | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|---|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | unidades de discos magnéticos; | |
| 8471.50.20 | <p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p> | <p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p> |
| 8471.50.30 | <p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C".</p> | <p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p> |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento. | |
| 8471.50.40 | UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria c) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicación, o alternativamente, el montaje de por lo menos 3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM", de los ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen también se aplica a las unidades de control de periférico, tales como controladoras de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y a las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.50.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.60.52 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.60.53 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.60.59 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8471.60.61 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.60.62 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.60.80 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8471.60.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.70.12 | DISCOS DUROS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.70.19 | DISCOS DUROS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8471.70.39 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.70.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.80.00 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8471.90.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.90.12 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.90.13 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8471.90.19 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8471.90.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8472.90.10 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8472.90.21 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8472.90.29 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8472.90.59 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8473.29.10 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | subpartida 8473.30. | (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8473.30.41 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8473.30.42 | PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8473.30.49 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8473.40.10 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8473.50.10 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8473.50.50 | PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductora no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8511.80.30 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.12.11 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.12 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.13 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.12.21 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.22 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.23 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.29 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.12.31 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.33 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.39 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.41 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.12.49 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.12.90 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.18.20 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.61.11 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.61.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.61.20 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.61.43 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.61.49 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.61.91 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.61.92 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.61.99 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.11 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.62.13 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.14 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.21 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.62.22 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.23 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.24 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.29 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.31 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | | demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.32 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.33 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.41 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.48 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.62.51 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.53 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.55 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.61 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.62.62 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.64 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.65 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.71 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.62.72 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.79 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.91 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.93 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8517.62.94 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.95 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.96 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.70.10 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8523.52.00 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. | |
| 8523.59.10 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8525.50.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8525.50.29 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8525.60.10 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8525.60.90 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8528.51.10 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8528.51.20 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8528.61.00 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8529.90.12 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8531.20.00 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8537.10.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8537.10.19 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8537.10.20 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8543.70.12 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8543.70.14 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|--|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 8543.70.15 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8543.70.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8543.70.39 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8543.70.91 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.33.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.33.19 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.39.10 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 9030.40.10 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.40.20 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.40.30 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 9030.40.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.82.10 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.82.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 9030.89.40 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.89.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9030.90.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 9031.80.40 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.21 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 9032.89.22 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.23 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.24 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| 9032.89.25 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.29 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.81 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.82 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa |

| NCM 2007 | DONDE DICE: | DEBE DECIR: |
|------------|---|--|
| | REQUISITO DE ORIGEN | REQUISITO DE ORIGEN |
| | C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.83 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.89.89 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 9032.90.10 | CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30. | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|--|
| | implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.59 | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.77 | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.78 | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.62.92 | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8517.69.00 | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8528.71.11 | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |
| 8538.90.10 | I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento. |

c) eliminar del listado:

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|---|
| 8443.31.00 | 60% de valor agregado regional. |
| 8443.32.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8443.32.12 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|--|
| | <p>las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p> |
| 8443.32.13 | <p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p> |
| 8443.32.19 | <p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p> |
| 8443.99.11 | <p>CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.</p> |
| 8443.99.13 | <p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p> |
| 8443.99.19 | <p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p> |
| 8443.99.21 | <p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p> |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|---|
| 8443.99.24 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8443.99.31 | 60% de valor agregado regional. |
| 8443.99.39 | 60% de valor agregado regional. |
| 8473.29.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.19 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.31 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|---|
| | establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.39 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.30.99 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.50.32 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.50.39 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8473.50.90 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|---|
| | en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8517.70.92 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8517.70.99 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8518.10.10 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8518.29.10 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8528.41.10 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8528.41.20 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8529.90.19 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8540.50.20 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|---|
| | en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. |
| 8541.10.22 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.10.29 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.10.92 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.10.99 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.29.20 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.30.21 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.30.29 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.40.16 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.40.21 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|---|
| | micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.40.22 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.40.26 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8541.40.31 | CELULAS FOTOVOLTAICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y D. Marcación (identificación). |
| 8541.40.32 | CELULAS FOTOVOLTAICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y D. Marcación (identificación). |
| 8541.50.20 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8542.32.21 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8542.32.29 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8542.32.91 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8542.33.90 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8542.39.39 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|--|
| | alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8542.39.99 | COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores. |
| 8543.70.92 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8543.70.99 | Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final. |
| 8544.70.10 | CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas. |
| 8544.70.30 | CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas. |
| 8544.70.90 | CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas. |
| 9001.10.11 | FIBRAS ÓPTICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma; B. Estiramiento de la fibra; C. Test; D. Embalaje; E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos). |
| 9001.10.19 | FIBRAS ÓPTICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma; B. Estiramiento de la fibra; C. Test; D. Embalaje; E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos). |
| 9001.10.20 | CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas. |
| 9026.10.11 | Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem |

| NCM 2007 | REQUISITO DE ORIGEN |
|------------|--|
| | <p>"A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p> |
| 9028.30.11 | <p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p> |
| 9028.30.21 | <p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p> |
| 9028.30.31 | <p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p> |